****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Texto y foto también disponible online en:* [*https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html*](https://www.congatec.com/es/congatec/notas-de-prensa.html)

**Nota de prensa**

congatec presenta un nuevo ecosistema para COM-HPC

**Importante hito para la integración del COM-HPC**

**Deggendorf, Alemania, 10 de noviembre de 2020 \* \* \*** congatec - proveedor líder de tecnología informática embebida y edge - presenta la primera placa carrier y soluciones de refrigeración que construyen la base del nuevo ecosistema para el nuevo estándar PICMG® COM-HPC™. Son un gran hito para la integración del COM-HPC y han sido creadas para acelerar la utilización de los módulos COM-HPC de congatec basados en los últimos procesadores de 11ª Gen Intel® Core™ (nombre en clave Tiger Lake). El nuevo estándar COM-HPC impresiona con una amplia gama con los últimos interfaces de alta velocidad como el PCIe Gen 4 y el USB4, un conector de alta velocidad preparado para el futuro y un completo conjunto de prestaciones para la gestión remota. Esto último, en particular, es de suma importancia para todas las aplicaciones edge conectadas de banda ancha que están surgiendo, que van desde los dispositivos edge dedicados a clouds edge robustas y fogs en tiempo real.

"Con nuestras soluciones COM-HPC y COM Express, ofrecemos dos opciones muy atractivas para la utilización de los últimos procesadores Intel Tiger Lake. Queremos animar a los ingenieros de sistemas a probar la nueva plataforma COM-HPC con todas sus nuevas características y beneficios. Esto es muy fácil de hacer ya que nuestras APIs son 100% idénticas en COM-HCP y COM Express, lo que significa que los ingenieros pueden trabajar en ambas plataformas y cambiar fácilmente de una a otra", explica Andreas Bergbauer, Product Line Manager de congatec.

Utilizar COM-HPC para el diseño de los procesadores de 11ª generación de Intel® Core™ proporciona beneficios inmediatos a los desarrolladores: Conectividad compatible con PCIe Gen4, ancho de banda USB 4.0 completo, 2.5 GbE, SoundWire y MIPI-CSI. Aquellos que esperan necesitar más o interfaces PCIe o Ethernet de mayor rendimiento con hasta 25 GbE también deben dar preferencia al COM-HPC. Además, los desarrolladores que quieran escalar sus sistemas de alto rendimiento hasta el rendimiento de los servidores edge y fog con un solo estándar, tienen un buen argumento para implementar todo en COM-HPC. Por último, la perspectiva de poder utilizar módulos que ofrezcan funciones de gestión remota más completas es otra razón para comprar y probar la nueva plataforma de evaluación del estándar COM-HPC.

**El conjunto de características en detalle**

Diseñada para propósitos de evaluación, la placa carrier compatible con ATX conga-HPC/EVAL-Client para COM-HPC incluye todas las interfaces de I+D necesarias para la programación, flashing de firmware y reseteo. La nueva placa COM-HPC también incorpora todos los interfaces especificados por el nuevo estándar del COM-HPC Client y soporta un rango de temperatura ampliado desde -40°C a +85°C. La placa soporta los tamaños COM-HPC A, B y C y viene con varios anchos de banda de datos LAN, métodos de transferencia de datos y conectores. Se ofrece en diferentes versiones para proporcionar la máxima flexibilidad a los clientes, incluyendo Ethernet KR, hasta 2x 10 GbE, 2,5 GbE y 1GbE de soporte. La placa cuenta además con 2 conectores PCIe Gen4 x16 de rendimiento masivo para las últimas tarjetas de extensión de alto rendimiento. Entre las placas de la gama, la carrier puede ejecutar interfaces de aún mayor rendimiento de hasta 4x25 GbE, lo que hace que esta plataforma de evaluación sea perfecta para los dispositivos edge conectados masivamente.

La solución de refrigeración para los nuevos módulos COM-HPC está disponible en 3 variantes diferentes y se adapta a toda la gama configurable de TPD de 12-28W de los procesadores Intel® Core™ de la 11ª generación. Los nuevos módulos COM-HPC están disponibles en las siguientes configuraciones de procesador:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Procesador** |  | **Núcleos/Threads** |  | **Frecuencia a 28/15/12W TDP, (Max Turbo) [GHz]** |  | **Cache [MB]** | **Unidades****Ejecución** **Gráfica** |  | **Rango de temperatura ampliado** |
|  | Intel® Core™ i7-1185G7E |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | - |
|  | Intel® Core™ i7-1185GRE |  | 4/8 |  | 2.8/1.8/1.2 (4.4) |  | 12 | 96 |  | si |
|  | Intel® Core™ i5-1145G7E |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | - |
|  | Intel® Core™ i5-1145GRE |  | 4/8 |  | 2.6/1.5/1.1 (4.1) |  | 8 | 80 |  | si |
|  | Intel® Core™ i3-1115G4E |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | - |
|  | Intel® Core™ i3-1115GRE |  | 2/4 |  | 3.0/2.2/1.7 (3.9) |  | 6 | 48 |  | si |
|  | Intel® Celeron® 6305E |  | 2/2 |  | 1.8 (n/a) |  | 4 | 48 |  | si |

La página de productos del conga-HPC/cTLU tiene su página principal en:

<https://www.congatec.com/es/productos/com-hpc/conga-hpcctlu/>

Para información sobre el estándar COM-HPC y su ecosistema completo, por favor visite: <https://www.congatec.com/com-hpc>

**Sobre congatec**

congatec es una empresa de tecnología de rápido crecimiento que se centra en productos informáticos embebidos y de vanguardia. Los módulos informáticos de alto rendimiento se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos en automatización industrial, tecnología médica, transporte, telecomunicaciones y muchas otros verticales. Respaldado por el accionista controlador DBAG Fund VIII, un fondo del mercado medio alemán que se enfoca en negocios industriales en crecimiento, congatec tiene la experiencia en financiación, fusiones y adquisiciones para aprovechar estas oportunidades de mercado en expansión. congatec es el líder del mercado global en el segmento de módulos COM con una excelente base de clientes desde nuevas empresas hasta compañías internacionales de primera línea. Fundada en 2004 y con sede en Deggendorf, Alemania, la empresa alcanzó una cifra de ventas de 126 millones USD en 2019. Más información disponible en nuestra web [www.congatec.com](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.congatec.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932424857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M6r1ukH%2B1yMwc0gunbmVRuBaaijO315wnAy2ocS4xvM%3D&reserved=0) o vía [LinkedIn](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F455449&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932434848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FMg3YUv0q09oP%2BW7%2FXJLHYdiBdwZeZbi5jJ7p%2B99RSE%3D&reserved=0), [Twitter](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobile.twitter.com%2FcongatecAG&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932444843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fp9Z0BnXIz0%2FlzJYotRWqmFrCf6949cCxX%2BbVDRBErs%3D&reserved=0) y [YouTube](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FcongatecAE&data=04%7C01%7C%7Cd6654884cfee4283460108d87b43e959%7C1b738660126645879d5454e9ad89e4cb%7C0%7C0%7C637394878932444843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jW4UF3e6O1zetb%2FFdq3Sq1R6T09OuPadNWqu6Fc%2FnY%3D&reserved=0).

\* \* \*

*Intel and Core, Celeron are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*